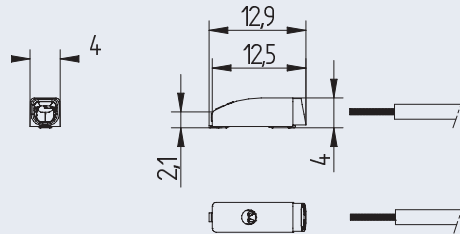
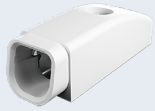


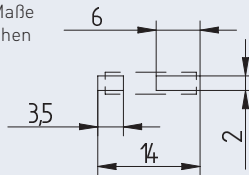
SMD-Leiterplattenklemmen

46.131 · SMD-Leiterplattenklemme - MiniFlex



Generelle Empfehlung: Die beiden Lötflächen eines Klemmpoles auf der Platine sollten elektrisch miteinander verbunden werden

Empfohlene Maße für die Lötflächen



SMD-Leiterplattenklemme MiniFlex mit Steckkontakten und Kontaktöffnungsfunktion

1-polig - 46.131.2001-0

Direktes Stecken von eindrätigen und feindrätigen, verzinnten Leitern, sowie feindrätigen Leitern durch Betätigen der Kontaktöffnungsfunktion

Kontaktöffnungsfunktion- auch zum Lösen bereits eingesteckter Leiter

Montage- und Verdrahtungsposition: Leiterplatte oberseitig

Automatengerechte "Tape-and-Reel" Verpackung

Befestigung: Bleifreie Reflow-Lötung nach DIN EN 610760-1, Abschnitt 6

Material: Gehäuse: PPA, weiß
Kontaktwerkstoff: CuNi
Kontaktoberfläche: feuerverzinkt

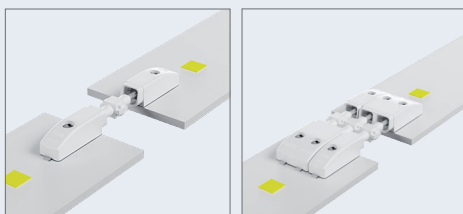
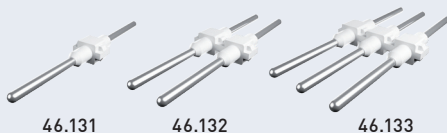
Zur Betätigung der Kontaktöffnungsfunktion, empfehlen wir den Einsatz unseres Werkzeugs 46.131.U802-0 und 46.131.E397-1

Daten zur Verpackung 46.131.2001-0	
Gewicht SMD-Klemme	0.20 g
Anzahl Klemmen pro Spule	2.650 Stück
Spulendurchmesser Gurtverpackung	381 mm - (15")
Gurtbreite	24 mm
Gewicht pro Spule	1.3 kg
Anzahl Spulen pro Karton	13 Stück
Anzahl SMD-Leiterplattenklemmen pro Karton	34.450 Stück
Gewicht pro Karton	15 kg
Abmessungen Karton (LxBxH)	400 x 405 x 415 mm



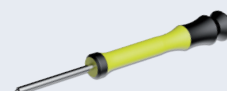
Zubehör:

SMD Mini-Flex-B2B-Verbinder. Zur Verbindung von Leiterplatten. Die Verbinder sind in den Längen 26 mm (U701), 28 mm (U702) und 30 mm (U703) erhältlich.



Werkzeug zur Kontaktöffnung

Zum Öffnen der Kontakte bei Einsatz von feindrätigen Leitern oder zur Entnahme bereits eingesteckter Leiter.



46.131.U802-0



46.131.E397-1

Integrierte Abisolierfunktion bei bereits angezogenen Leiterenden

Anschlussdaten	
Anschlusstechnik	Steckkontakt
Eindrähtige Leiter	0.20 - 0.75 mm ² , AWG 24-18
Feindrähtige, verzinnte Leiter	0.20 - 0.5 mm ² , AWG 24-20
Feindrähtige Leiter	0.20 - 0.75 mm ² , AWG 24-18
Abisolierlänge (ø < 2.1 mm)	8 +1 mm
Abisolierlänge (ø 2.1 - 2.7 mm)	9 +1mm
Leitereinführung	0°
Leiterlösefunktion mittels	Werkzeug zur Kontaktöffnung

Auszugskraft nach DN 60999-1

0.2 mm ²	min. 10 N
0.34 mm ²	min. 15 N
0.5 mm ²	min. 20 N
0.75 mm ²	min. 30 N
Einsteckkraft	max. 10 N

Geometrische Daten

Rastermaß	4 mm / 0.16 inch
Breite	4 mm / 0.16 inch
Höhe	4 mm / 0.16 inch
Tiefe	12.9 mm / 0.51 inch

Werkstoffdaten

Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	PPA, weiß
PTI	600
Entflammbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Kontaktwerkstoff	CuNi
Kontaktoberfläche	feuerverzinkt

Mechanische Daten

Montageposition	Leiterplatte oberseitig
Befestigungsart	Bleifreies Reflow-Löten

Temperaturbedingungen

Grenztemperaturbereich	-70 °C bis + 150 °C
Umgebungstemperatur	-70 °C bis + 125 °C
T-Klassifizierung nach IEC 60998-1 Abs. 12	120° C

Bemessungsdaten gemäß IEC / EN 60947-7-4 (IEC/EN 60664-1)

Bemessungsspannung (III / 3)	63 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	2.5 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	2.5 kV
Bemessungsspannung (II / 2)	320 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	2.5 kV
Bemessungsstrom	9 A

Bemessungsdaten gemäß UL 1977 / CSA-C22.2 No. 182.3

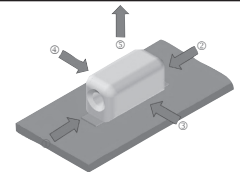
Bemessungsspannung	600 V
Bemessungsstrom	USR 9 A, AWG 24 -18 CNR 6 A, AWG 24-20 CNR 9 A, AWG 18

Länderspezifische Zulassungen Zertifikate

VDE / ENEC	EN IEC 60947-7-4 Ausweis-Nr.: 40040866
cURus	UL 1977 / CSA-C22.2 No. 182.3 File no.: E-365006

Scherkräfte nach IEC 62137-1-2.

Bei diesen Werten handelt es sich um Maximumwerte, die nur für eine kurzzeitige Belastung gelten, nicht für Dauerbelastung.

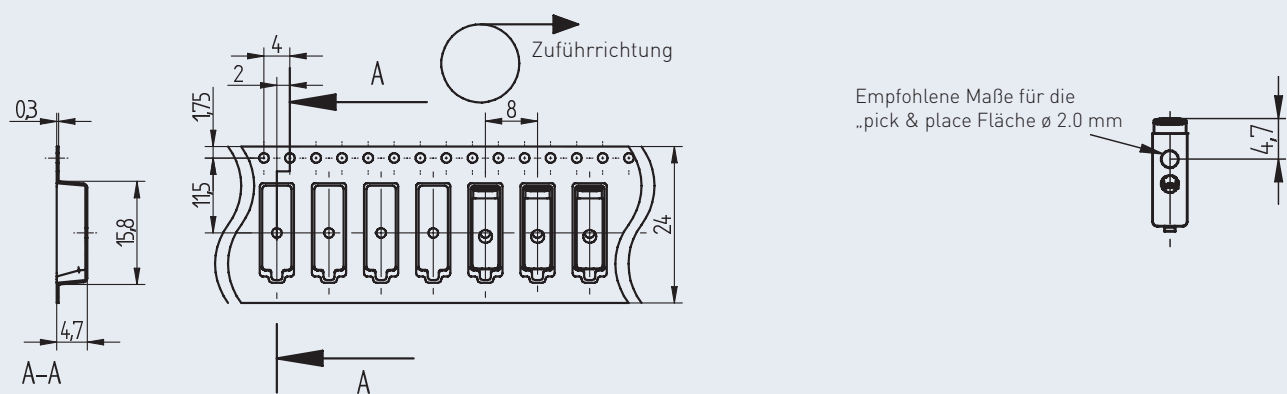


Richtung 1 + 2 Scherkraft längs	50 N
Richtung 3 + 4 Scherkraft quer	20 N
Richtung 5 Abzugskraft	20 N

Hinweise zur Verarbeitung

Geeignet für bleifreie Reflow-Lötprofile in Anlehnung an DIN EN 61760-1 bzw. DIN EN 60068-2-58 bis zu einer Peak-Temperatur von max. 260 °C. Aufgrund von unterschiedlichen anwendungsspezifischen Einflussgrößen (Bauteilanordnung und -ausrichtung, Lötanlage, Lötpaste) wird empfohlen, mittels Testläufen ein geeignetes Profil unter Fertigungsbedingungen zu ermitteln.

Abhängig vom SMD-Prozess und den Lötparametern kann eine leichte Verfärbung auftreten, welche jedoch die technische Funktionsweis nicht beeinflusst.



Lagerdauer	Lötbarkeit bei Lagerung zwischen -5°C und +40°C bei 10 - 60 %rH bis zu 6 Monaten. Bei Verarbeitung nach mehr als 6 Monaten sollte die Lötbarkeit gemäß J-STD-002D oder DIN EN 60068-2-58:2016 überprüft werden.
max. zulässige Reflowvorgänge	3
Lötprofil	Reflow-Profil (bleifreies Löten): $T_{max} = 260\text{ °C}$ $t_{max} < 10\text{ sec}$ $T_L \geq 230\text{ °C}$ $t_L = 20 - 60\text{ sec}$ $T_s = 150\text{ °C} - 180\text{ °C}$ $t_s = 60 - 120\text{ sec}$
Lötbarkeit	Lötbarkeit der Bauteile ist durch Benetzungstest gemäß J-STD-002D geprüft
Montageverfahren	SMD, nach Zeichnung
Materialstärke SMD-Schablone	100 - 150 µm (Empfehlung BJB 150 µm)